

证券代码：688173

证券简称：希荻微

记录编号：2026-IR-007

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	【东方财富证券股份有限公司】：欧阳冉，李和洲 【东方财富信息股份有限公司】：黄珊 【广东天创私募证券投资基金管理有限公司】：钟复镜 【广东顺银私募基金管理有限公司】：宿少华，黄创宇 【广州复泉私募证券投资基金管理有限公司】：吴孔云 【广州顺辰企业管理咨询有限公司】：陈鹏 【中金资本管理（广东）有限公司】：刘弦 【广东燊茂私募基金管理有限公司】：李旭明 【广州市知本复利投资有限公司】：陈九宇 【佛山市一懿资本投资有限公司】：何愿文 【广东玖远投资咨询有限公司】：黄英华 【广东凯鼎投资有限公司】：甄义勇

	【南通熙宁投资管理有限公司】：邓绍伟
时间	2026 年 7 月 15 日 15:00-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	【主讲人】： 吴昊晟 高级投关经理
投资者关系活动主要内容介绍	Q: 请问公司第一大股东和实际控制人的关系？股权继承是否存在风险？ A: 公司第一大股东戴祖渝女士系原共同实际控制人之一，于 2025 年 5 月逝世。经广东省深圳市先行公证处公证，其所持公司股份由长子 TAO HAI 依法继承。目前，股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措，股份继承过户尚未办理完成。需特别说明的是，表决权已依法委托 TAO HAI 行使，且 TAO HAI（现任公司董事长）与唐娅（现任公司总经理）签署的一致行动协议持续有效，公司控制权结构清晰、稳定，不存在因继承事项导致控制权变更的风险。 Q: 近期董监高及股东减持引发市场关注，公司如何看待？ A: 公司近期披露的减持计划主要来自于 IPO 前的财务投资机构及公司高管基于自身资金需求的安排，均严格履行预披露义务，减持比例较小，属资本市场正常行为。公司实际控制人 TAO HAI 与唐娅坚定看好公司发展，未披露任何减持计划，且核心技术人员保持稳定。我们认为，短期的交易行为不影响公司长期基本面与内在价值。 Q: 公司境外业务收入占比较高，背后的业务逻辑是什么？ A: 公司境外收入占比较高主要由三大因素驱动，符合集成电路设计行业惯例：（1）平台认证路径：公司早期即通过高通（Qualcomm）等国际主芯片平台参考设计，切入全

	球头部品牌供应链，此类客户多采用境外主体结算；（2）并购整合因素：2024 年收购的韩国公司 Zinitix，其传感器业务（包含 Touch 触控芯片及 Haptic 触觉反馈驱动芯片等）主要分布于境外市场；（3）贸易结算便利：部分境内客户通过香港子公司进行采购，以便利外汇结算与物流通关。若按终端客户所在地划分，公司产品主要服务于中国及全球主流消费市场，并非单纯的“出口依赖”。 Q：请问公司对海外子公司 Zinitix 的管控情况如何？ A：公司对 Zinitix 已实现全面、深度的有效管控：（1）股权巩固：2026 年 4 月，公司通过全资子公司美国希荻微参与 Zinitix 定增，目前合计持股比例达 47.62%，控股地位进一步巩固；（2）治理穿透：公司已向 Zinitix 派驻董事、关键管理人员，将其纳入集团全面预算管理体系，实施严格的费用管控与财务监督；（3）业务协同：公司管理层常态化赴韩参与其重大经营决策；同时推动 Zinitix 深圳代表处与公司深圳团队联合办公，实现“韩国研发+中国市场”及“中国产品+海外渠道”的双向赋能。 Q：目前半导体产能紧张，公司的产能保障情况如何？ A：公司采用 Fabless（无晶圆厂）经营模式，晶圆制造与封装测试均委托第三方合作伙伴完成。目前成熟制程 8 英寸产能行业整体供需偏紧，公司通过与境内外主流晶圆厂、封测厂建立长期战略合作及“国内+国际”双循环供应链策略，供应商资源储备充裕，整体产能可匹配下游订单需求，不存在重大交付瓶颈。 Q：公司车规芯片的产品布局及最新进展如何？ A：公司车规芯片产品矩阵涵盖车规级 DC/DC 芯片、LDO
--	--

	稳压器、高/低边开关驱动芯片及车载摄像头 PMIC 等，主要应用于智能座舱与车身控制领域。2026 年第一季度，车规业务同比增速较快。此外，诚芯微于 2026 年 3 月正式成为公司子公司，其主营的车载充电方案使公司车规产品线得到进一步补充。目前，公司已新增多家头部车企定点项目，预计随车型 SOP（标准量产）将步入持续放量期。 Q：公司在 AI 领域的布局有哪些实质性进展？ A：公司在 AI 领域的布局兼具“端侧”与“云端”：（1）AI 端侧：公司高性能电源管理芯片已切入 AI 手机及 AI 眼镜供应链，进入雷鸟、亿境、夸克及 Meta 等国内外头部品牌；（2）AI 算力：针对 PC 及服务器 GPU 供电需求，公司推出了大电流 POL 芯片系列。目前，10-20A POL 产品已实现向国内信创客户出货，20-50A 产品正配合客户进行系统级验证，为算力硬件提供核心动力支撑。 Q：相比国内友商，公司的核心竞争优势体现在哪些方面？ A：公司的差异化竞争优势主要体现如下几点：（1）高端认证壁垒：公司是国内少数进入高通、联发科主芯片参考设计的电源管理芯片厂商，技术性能对标国际大厂；（2）双赛道卡位确立先发优势：公司车规级电源管理芯片产品已通过 AEC-Q100 认证，并在国内外主流车企前装量产；在 AI 算力领域，公司前瞻性布局数据中心与高性能计算赛道，相关电源产品已逐步落地，成长空间广阔；（3）国际化整合能力：公司通过并购整合在音圈马达驱动芯片、触控芯片以及触觉反馈驱动芯片等领域形成了独特的技术互补优势，构建了平台型模拟芯片设计能力。 Q：消费电子周期波动较大，公司如何应对并保证业绩？
--	--

	A：在消费电子领域，公司依托高通平台认证，持续导入全球知名品牌头部客户，逐步提升份额。2026 年第一季度，公司营收同比增长 41.50%，归母净利润亏损同比收窄 71.98%，减亏趋势明确。此外，公司加速向汽车电子、AI 算力等高壁垒领域转型。随着高毛利产品占比提升，公司盈利结构将持续优化，抗周期能力显著增强。 Q：请问诚芯微的业绩承诺完成情况如何，是否存在商誉减值风险？本次收购预计对公司财务报表的影响？ A：根据审计报告，诚芯微 2025 年业绩承诺完成率达 102.81%。鉴于诚芯微 2025 年业绩达标且业务整合顺利，目前暂未发现商誉减值迹象。自 2026 年第二季度起，诚芯微已实现 100%并表，预计将对公司营收规模及综合毛利率产生正向拉动作用，具体数据请以定期报告为准。 Q：请问公司最新一期股权激励的目标如何设置？ A：公司 2026 年股权激励首次授予对应公司层面的业绩考核目标是以 2025 年营业收入为基数，2026-2030 年营业收入的增长率分别不低于 8%/16%/24%/32%。阶梯化设定相对稳健，该业绩目标是在高基数及行业周期波动下的底线管理，确保激励可达性与员工绑定。 Q：请问公司后续在研发投入上的规划是怎样的？ A：研发创新是公司发展的核心驱动力。上市以来，公司研发投入占营收比例保持在高位，研发人员占比约 60%。展望未来，公司将重点聚焦于 AI 等前沿领域，通过高研发投入构筑技术护城河，确保在高端模拟芯片及数模混合芯片领域的国产替代进程中保持领先地位。
关于本次活动是	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公

否涉及应当披露重大信息的说明	开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 15 日